

# 2018年3月期 第1四半期（2017年4月～6月） 東京エレクトロン 決算説明会

2017年7月27日

内容：

- 第1四半期連結決算の概要 代表取締役・CFO、専務執行役員 堀 哲朗
- 事業環境および業績予想 代表取締役社長・CEO 河合 利樹

# 将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ

# 第1四半期 連結決算の概要

2017年7月27日

堀 哲朗

代表取締役・CFO、専務執行役員



## 2018年3月期 第1四半期のハイライト

- 前年同期比で売上高884億円増加 (+60%)  
営業利益326億円増加 (+148%)
- 売上総利益率40%以上、営業利益率23%以上と高水準を維持  
期初計画に沿って進捗
- FPDセグメント利益率は減少するも、想定通り  
通期ベースでの利益率は予定通り改善を見込む

FPD: フラットパネルディスプレイ製造装置

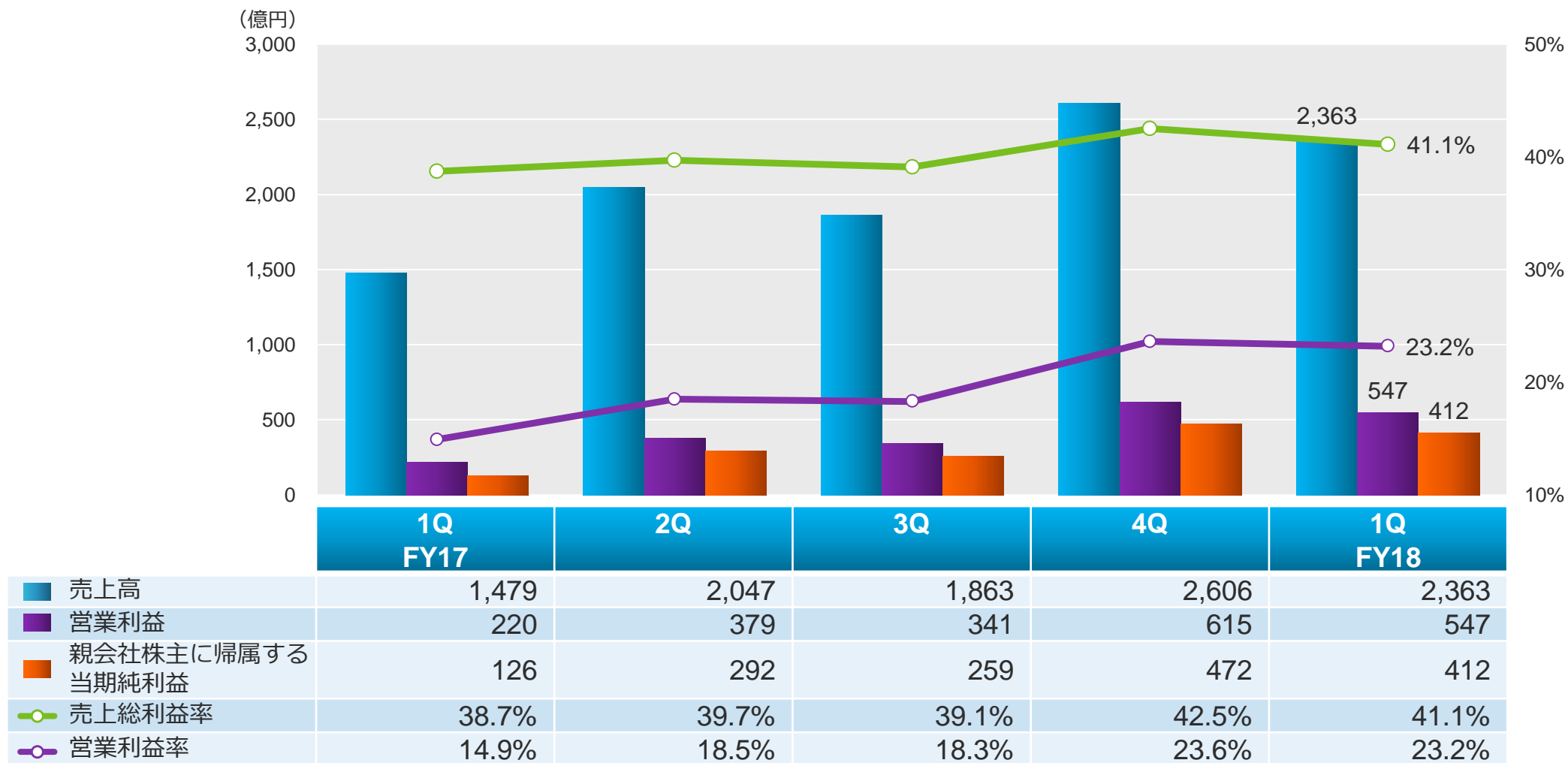
# 損益状況

(億円)

|                     | 2017年3月期     |              |              |                | 2018年3月期     | 対前年4Q<br>増減率      |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|
|                     | 1Q           | 2Q           | 3Q           | 4Q             | 1Q           |                   |
| 売上高                 | 1,479        | 2,047        | 1,863        | 2,606          | 2,363        | -9.3%             |
| 売上総利益<br>下段：売上総利益率  | 573<br>38.7% | 813<br>39.7% | 729<br>39.1% | 1,106<br>42.5% | 971<br>41.1% | -12.2%<br>-1.4pts |
| 販管費                 | 352          | 434          | 387          | 491            | 423          | -13.8%            |
| 営業利益<br>下段：営業利益率    | 220<br>14.9% | 379<br>18.5% | 341<br>18.3% | 615<br>23.6%   | 547<br>23.2% | -11.0%<br>-0.4pts |
| 税前利益                | 161          | 382          | 332          | 614            | 551          | -10.3%            |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 126          | 292          | 259          | 472            | 412          | -12.8%            |
| 研究開発費               | 177          | 220          | 191          | 248            | 211          | -14.6%            |
| 設備投資額               | 38           | 55           | 41           | 71             | 81           | +13.5%            |
| 減価償却費               | 39           | 42           | 45           | 50             | 42           | -16.7%            |

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。  
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

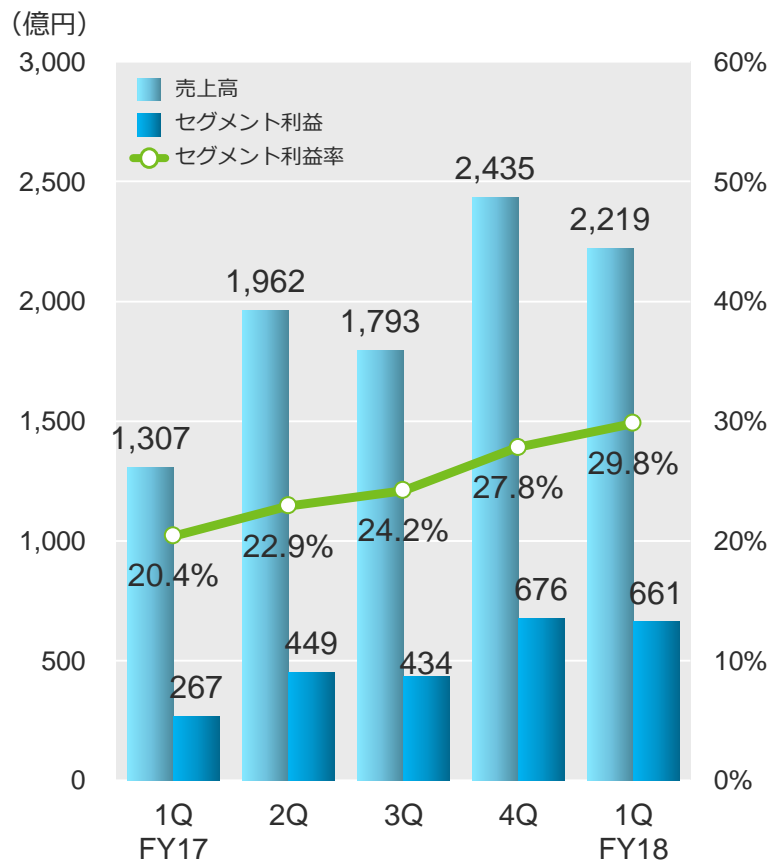
# 損益状況



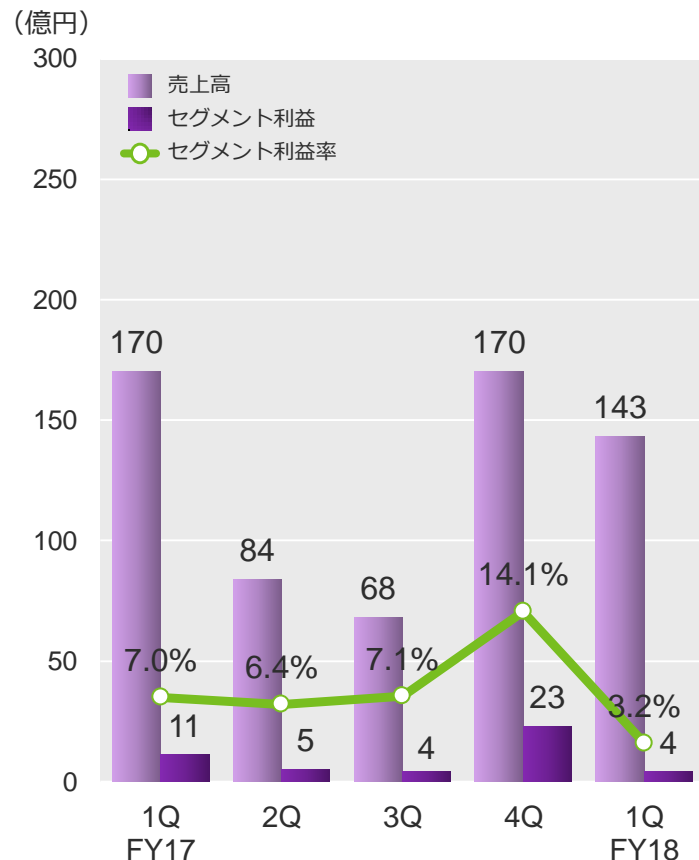
売上総利益率、営業利益率ともに高水準を維持

# セグメント情報

## SPE (半導体製造装置)



## FPD (フラットパネルディスプレイ製造装置)



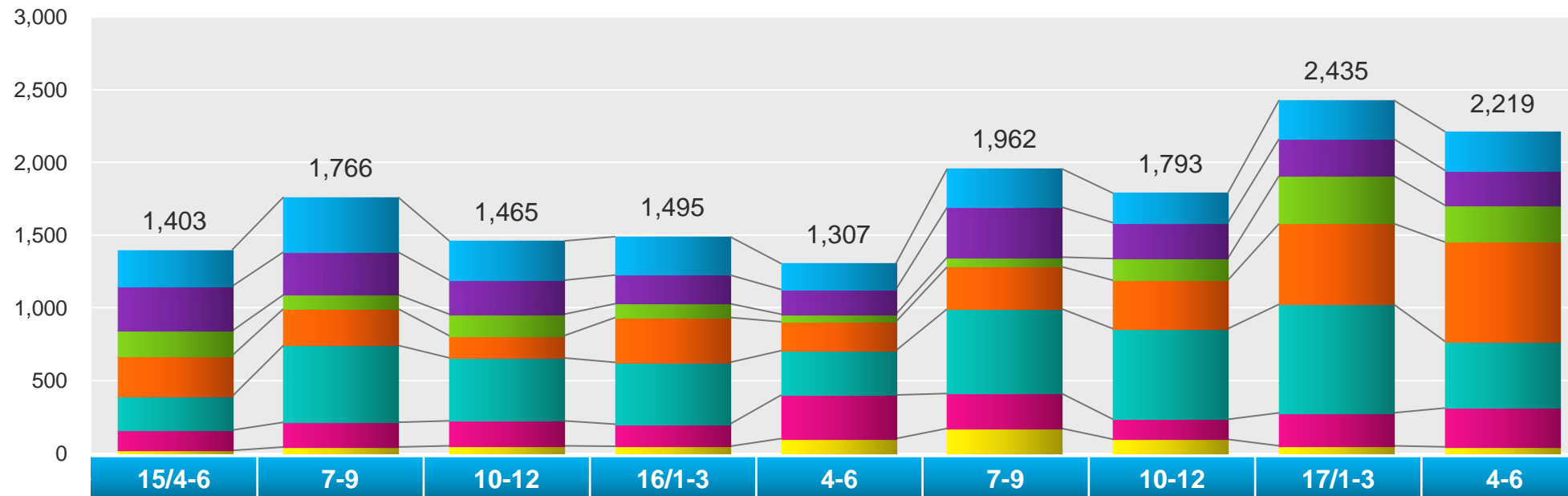
## 売上構成比率



1. セグメント利益は、税前利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用（主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費）があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

# SPE部門 地域別売上高

(億円)

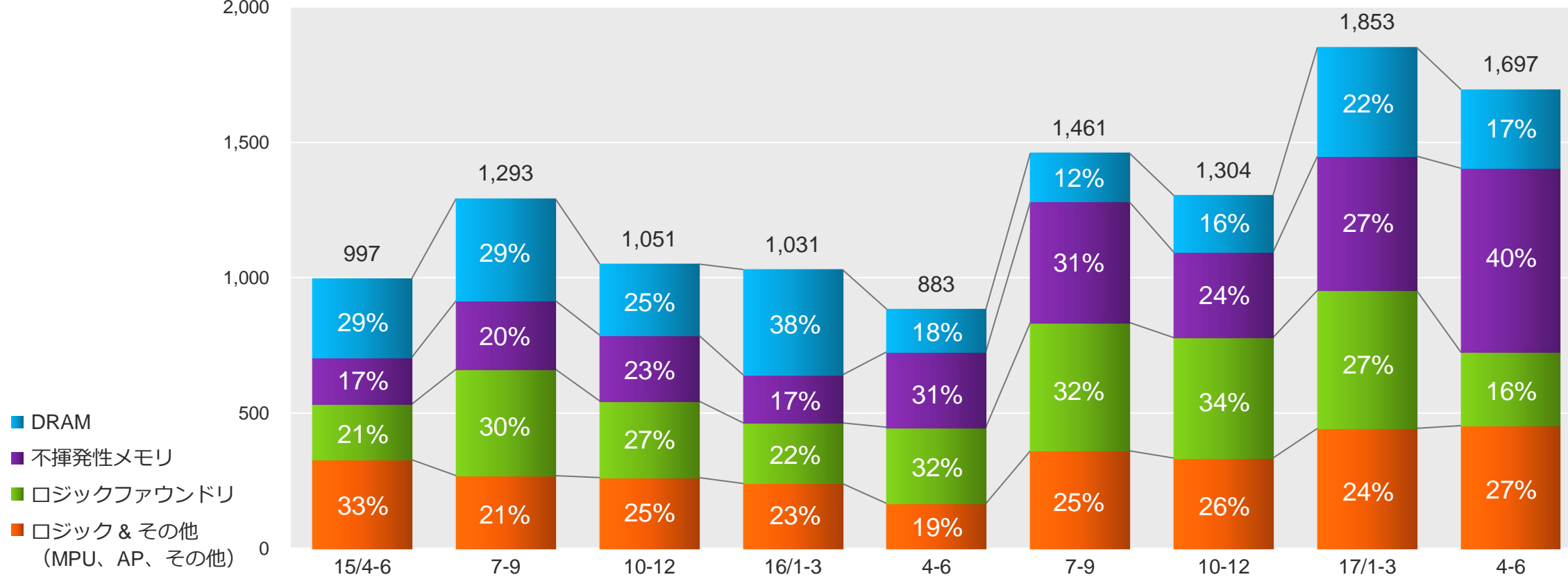


|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ■ 日本      | 250 | 378 | 270 | 264 | 178 | 264 | 203 | 266 | 267 |
| ■ 北米      | 307 | 294 | 234 | 197 | 170 | 344 | 246 | 254 | 240 |
| ■ 欧州      | 170 | 96  | 148 | 95  | 52  | 66  | 150 | 329 | 253 |
| ■ 韓国      | 281 | 252 | 152 | 309 | 198 | 290 | 333 | 555 | 683 |
| ■ 台湾      | 231 | 529 | 433 | 425 | 305 | 582 | 623 | 747 | 458 |
| ■ 中国      | 140 | 170 | 172 | 152 | 300 | 240 | 137 | 227 | 267 |
| ■ 東南アジア・他 | 21  | 45  | 53  | 50  | 103 | 173 | 98  | 53  | 46  |



# SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比

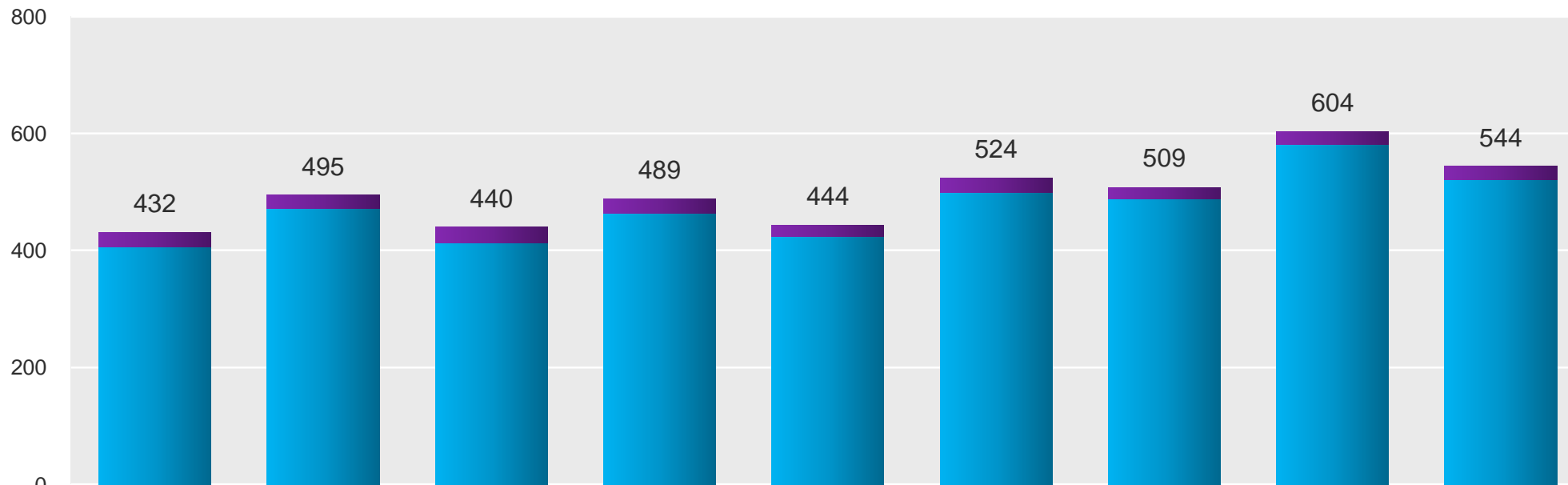
(億円)  
2,000



韓国のNAND向けが増加  
台湾のファウンドリおよびDRAMが減少

# フィールドソリューション売上高

(億円)

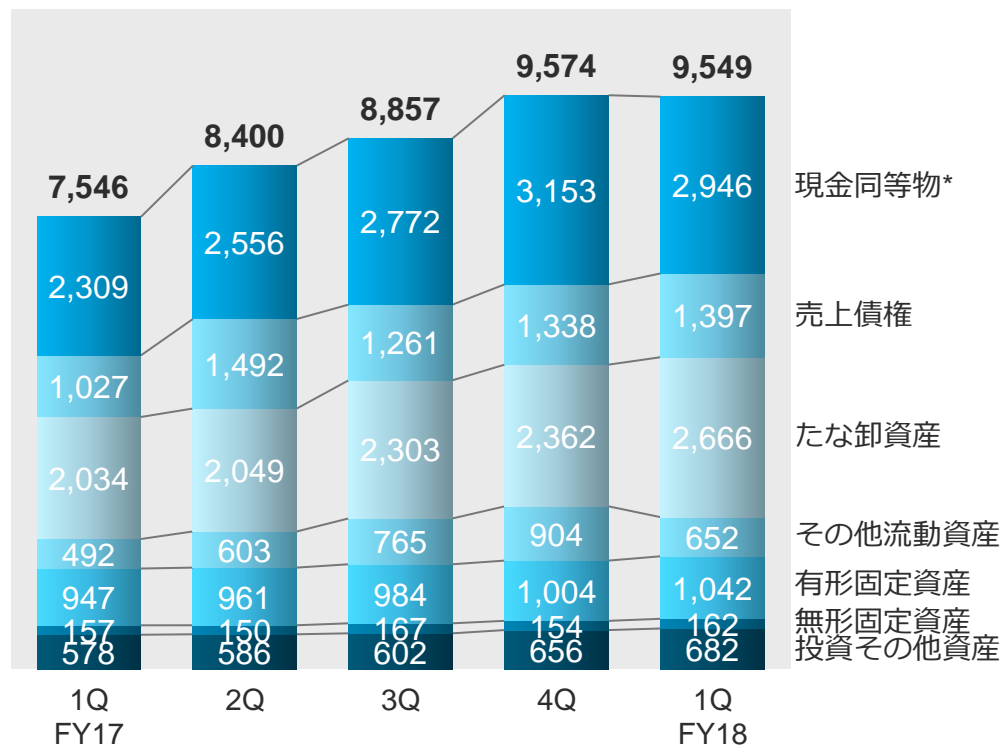


|        | 15/4-6 | 7-9 | 10-12 | 16/1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 17/1-3 | 4-6 |
|--------|--------|-----|-------|--------|-----|-----|-------|--------|-----|
| SPE売上高 | 406    | 472 | 413   | 464    | 424 | 500 | 488   | 581    | 522 |
| FPD売上高 | 25     | 23  | 27    | 24     | 20  | 24  | 20    | 22     | 22  |

# 貸借対照表

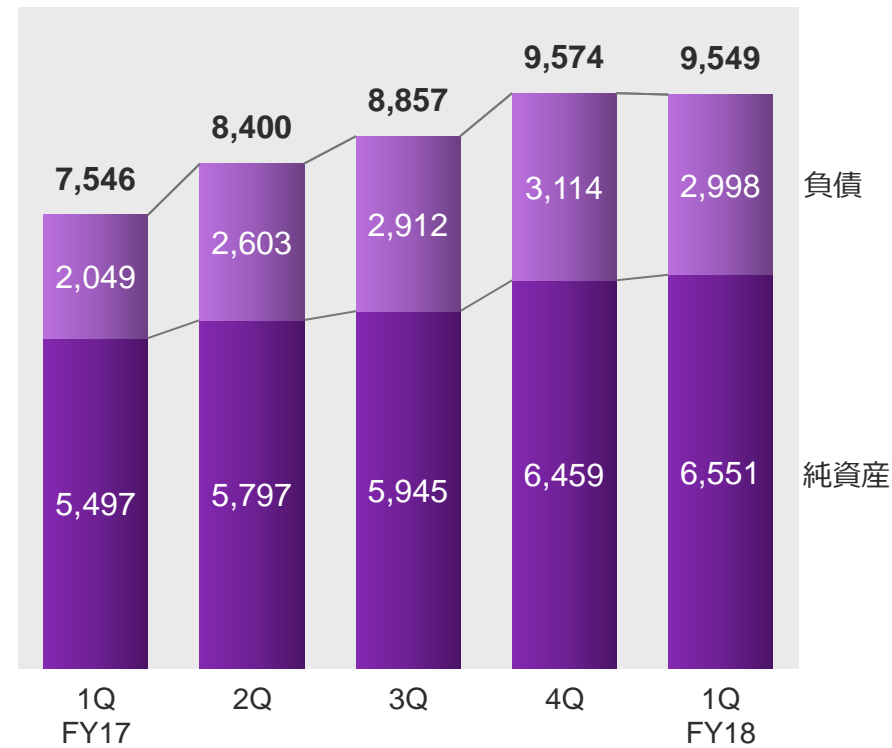
## 資産

(億円)



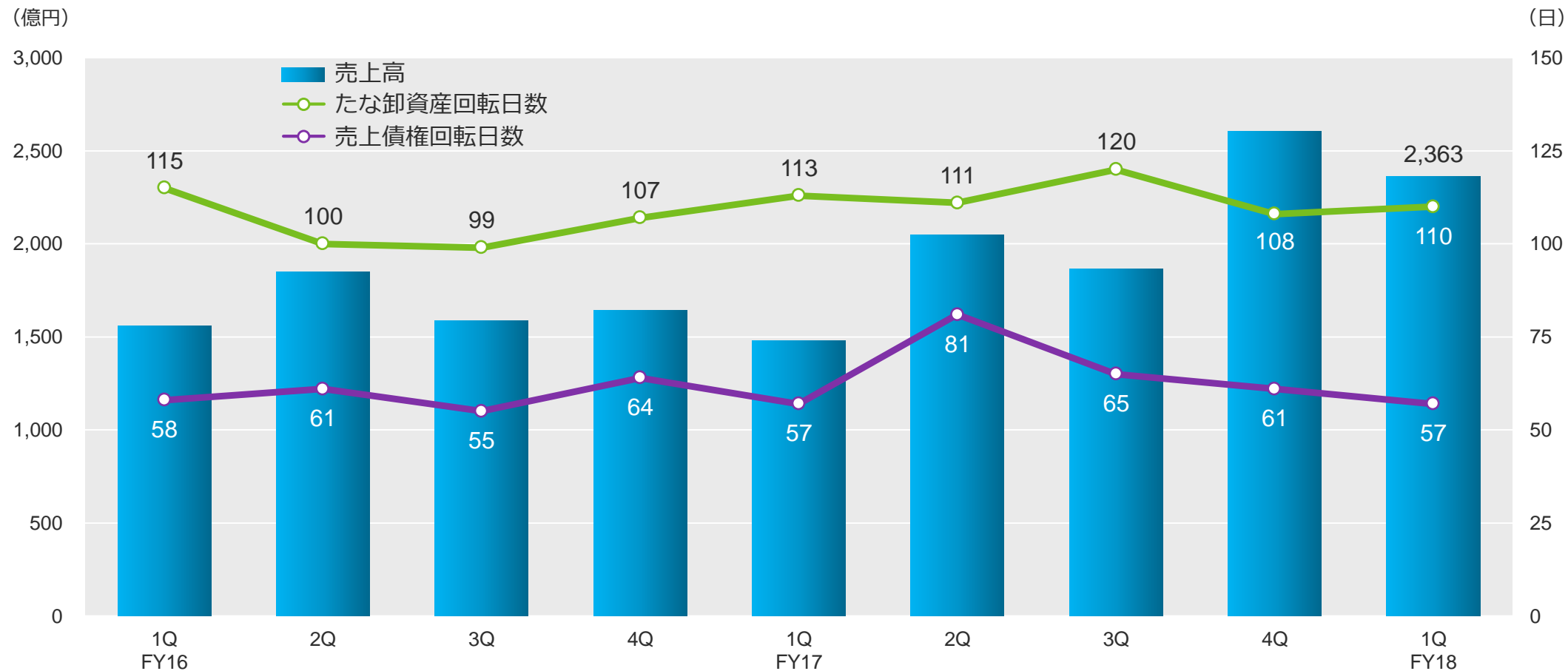
## 負債・純資産

(億円)



\* 現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

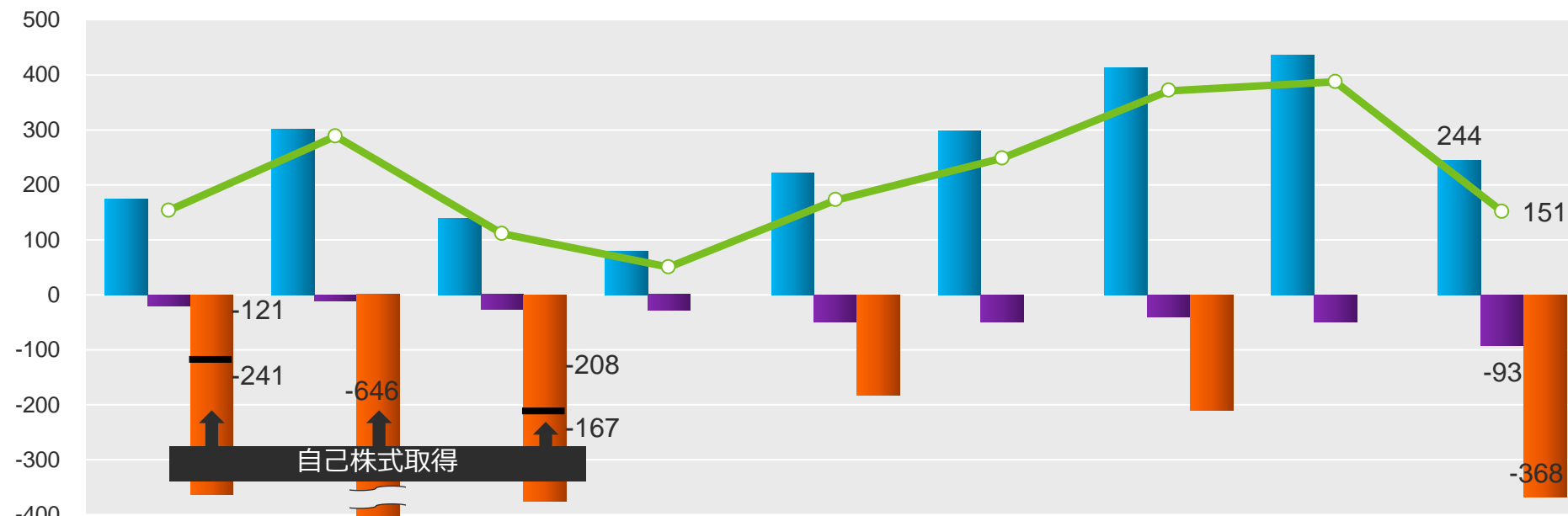
# たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

# キャッシュ・フロー

(億円)



|                  | 1Q FY16 | 2Q    | 3Q    | 4Q    | 1Q FY17 | 2Q    | 3Q    | 4Q    | 1Q FY18 |
|------------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|
| ■ 営業キャッシュ・フロー    | 173     | 301   | 138   | 79    | 221     | 298   | 413   | 436   | 244     |
| ■ 投資キャッシュ・フロー*   | -20     | -12   | -27   | -29   | -49     | -49   | -41   | -49   | -93     |
| ■ 財務キャッシュ・フロー    | -363    | -646  | -375  | 0     | -183    | 0     | -210  | -0    | -368    |
| ○ フリーキャッシュ・フロー** | 153     | 288   | 111   | 50    | 172     | 248   | 371   | 387   | 151     |
| 手元資金残高***        | 2,989   | 2,607 | 2,338 | 2,366 | 2,309   | 2,556 | 2,772 | 3,153 | 2,946   |

\* 投資キャッシュ・フローは、満期3ヶ月超の預金等の増減額を除いた金額です。

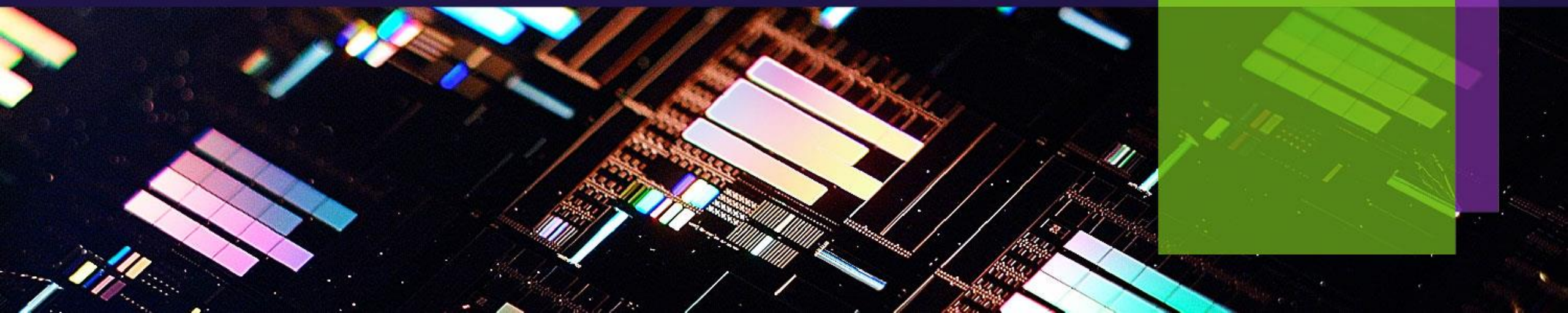
\*\* フリーキャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー (満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く)

\*\*\* 手元資金とは、現金及び現金同等物と満期3ヶ月超の預金等の合計金額です。

# 事業環境および業績予想

2017年7月27日

河合 利樹  
代表取締役社長・CEO



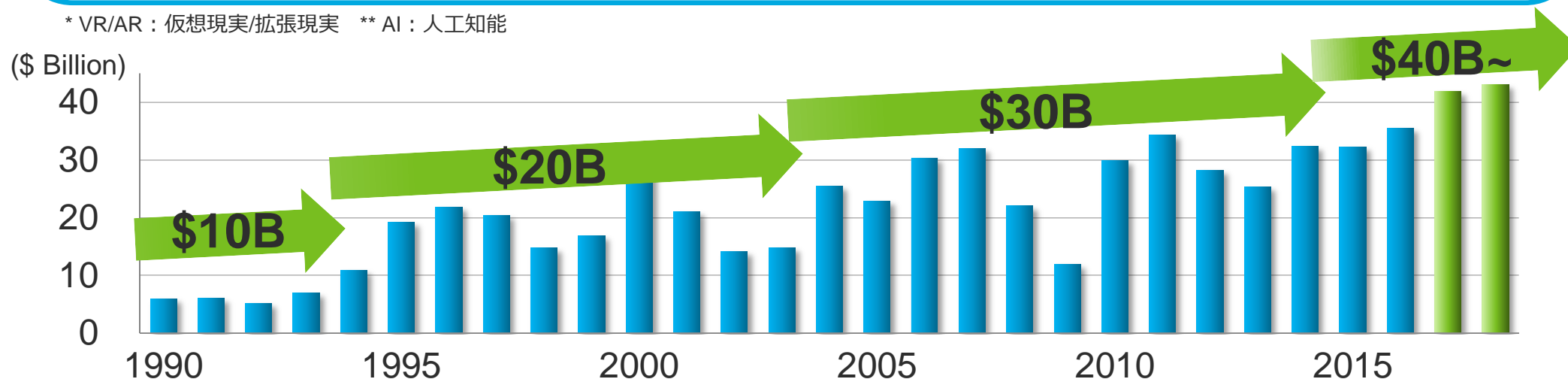
# 半導体前工程製造装置(WFE)市場の展望

## 将来の成長ドライバー

PC・インターネット・モバイル  
+  
VR/AR\*・IoT・AI\*\*・機械学習  
ビッグデータ・自動運転・個別化医療

WFE市場は  
**\$40B以上に成長**  
先端ロジック・メモリ向けともに  
投資拡大

\* VR/AR : 仮想現実/拡張現実 \*\* AI : 人工知能



半導体用途の広がりにより、装置市場は一段上のフェーズへ

## 事業環境（2017年7月時点での見方）

### ▶ 半導体設備投資

CY2017の半導体前工程製造装置(WFE)\*の設備投資額は、次世代3D NANDおよび先端ノード向けロジック投資の立ち上がりにより、前年比10%以上の成長を予想

### ▶ FPD設備投資

CY2017のTFTアレイ工程\*\*向けのFPD製造装置の需要は、モバイル用途の中小型パネル向け設備投資の継続と第10.5世代の立ち上がりにより、前年比30%程度の増加を見込む

装置市場は、IoTと次世代技術への活発な投資により成長が加速

\* 半導体前工程製造装置（WFE; Wafer fab equipment）：半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

\*\* TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動する電気回路機能を持つ基板を製造する工程



# CY2017 アプリケーション別の市場成長と事業機会

- NAND：前年比30%程度の市場成長を予想
  - 牽引役：データ通信量増加に伴うデータセンタ向けSSD需要
  - 設備投資：6X/7X層数世代向けが7割、2017年末に月産70万枚の3D NAND生産設備を見込む
  - 事業機会：市場拡大とシェア向上、次世代9X/12X層数世代での工程拡大に注力
- DRAM：5-10%の増加
  - 牽引役：モバイルの平均搭載容量は前年比25%増加、サーバも40%増加
  - 設備投資：1Xnm世代向け設備投資が6割
  - 事業機会：一括パターンニング、配線工程で差別化
- ロジック/ファウンドリ：同水準を予想
  - 牽引役：高性能化、省エネ化の需要
  - 設備投資：最先端10/7nm世代向けが7割
  - 事業機会：難易度の高まるパターンニングでのビジネス拡大

## 2018年3月期 第1四半期 事業進捗

- SPE注力分野（エッチング、成膜、洗浄装置）の事業戦略は計画通り進捗
  - CY2017は注力3装置分野のすべてにおいてシェア向上を見込む
- FPD製造装置
  - 第10.5/第11世代におけるリーディングポジション確立
- 宮城工場（エッチング装置）の生産能力を、CY2019までに2倍に増強（今期の全社の設備投資予定 420億円に変更なし）
  - 現在建設中の新物流棟により生産効率を向上
  - 工場内の生産ラインを現在の2倍に増強



プラズマエッチング装置  
Tactras™



東京エレクトロン宮城

# 2018年3月期 業績予想

# 2018年3月期 業績予想 (2017/4/28発表から変更なし)

(億円)

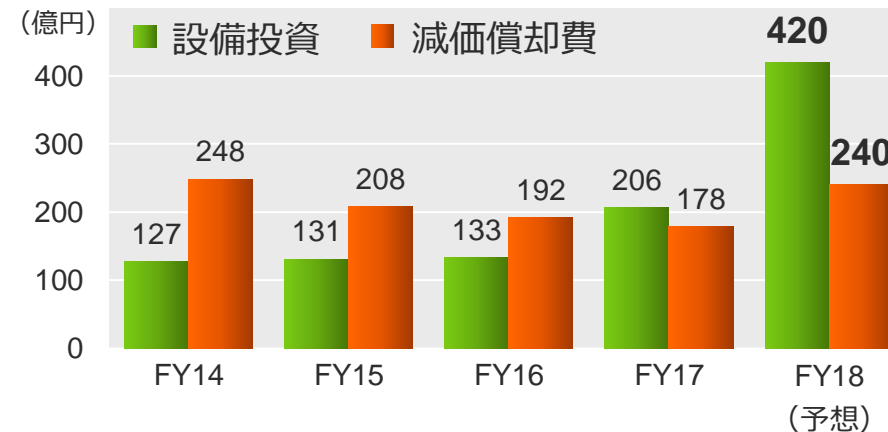
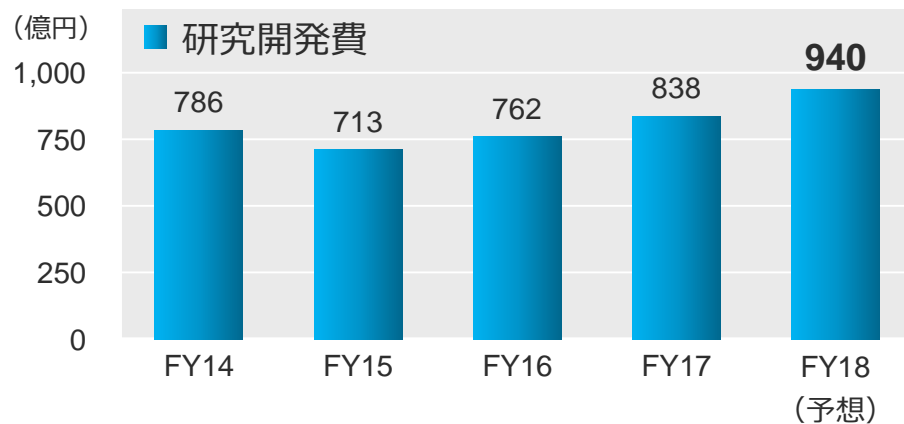
|                     | FY2017<br>(実績) | FY2018 (予想)    |                |                |                 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                     |                | 上期             | 下期             | 通期             | 対前年増減           |
| 売上高                 | 7,997          | 4,800          | 5,000          | 9,800          | +22.5%          |
| SPE                 | 7,498          | 4,510          | 4,590          | 9,100          | +21.4%          |
| FPD                 | 493            | 290            | 410            | 700            | +41.7%          |
| 売上総利益<br>下段：売上総利益率  | 3,222<br>40.3% | 2,020<br>42.1% | 2,100<br>42.0% | 4,120<br>42.0% | +897<br>+1.7pts |
| 販管費                 | 1,665          | 980            | 980            | 1,960          | +294            |
| 営業利益<br>下段：営業利益率    | 1,556<br>19.5% | 1,040<br>21.7% | 1,120<br>22.4% | 2,160<br>22.0% | +603<br>+2.5pts |
| 税前利益                | 1,491          | 1,040          | 1,120          | 2,160          | +668            |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 1,152          | 790            | 840            | 1,630          | +477            |
| 1株当たり当期純利益 (円)      | 702.26         | 481.48         | 511.96         | 993.44         | +291.18         |

## 市場成長以上の売上拡大、2期連続の過去最高益を見込む

SPE: 半導体製造装置、FPD: フラットパネルディスプレイ製造装置

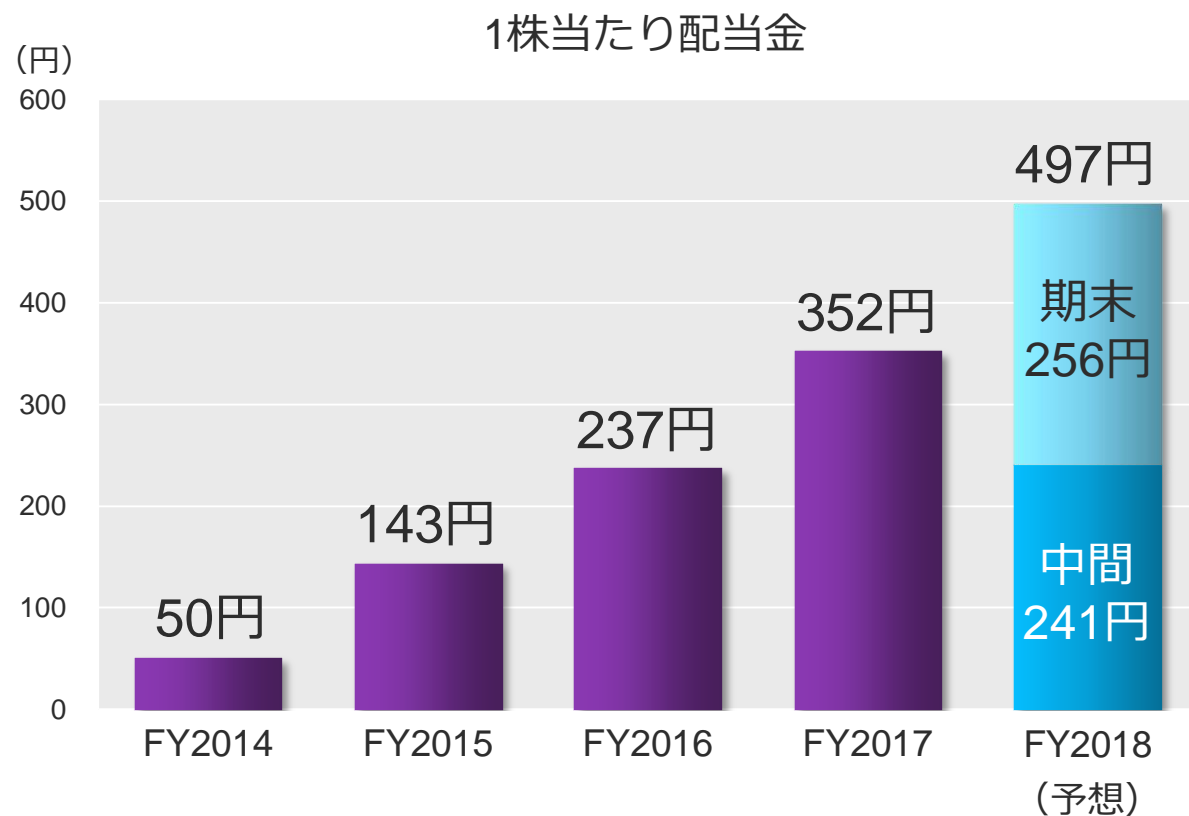
# 研究開発費・設備投資計画（2017/4/28発表から変更なし）

- 開発費 940億円
  - 注力分野および持続的成長を見据えた投資継続
- 設備投資 420億円
  - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 240億円



装置市場の新たなフェーズに向けた積極的な先行投資を予定

# 2018年3月期 配当予想 (2017/4/28発表から変更なし)



## 当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

1株当たり配当金は、前期比40%以上の増配を予定

**TEL**<sup>TM</sup>

**TOKYO ELECTRON**